

HITACHI

日立ケーイーシステムズ

Embedded Computer BP3 Series

組み込み用コントローラ
BP3シリーズ



製品の特長

Windows® 11 IoT 対応

最新の組み込み用OS Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSCを搭載。デジタルサイネージプレイヤーや産業機器、設備管理機器、計測機器、検査機器、ThinClient、IoTゲートウェイやエッジデバイスなど組み込み用コントローラとして幅広い用途でご利用頂けます。

省電力プロセッサ搭載

薄型モデルはIntel N97、インターフェース拡張モデルはAMD Ryzen Embedded R2314を搭載。省電力プロセッサの採用によりファンレス機構を実現

用途に合わせた2ラインナップ

狭い場所でも設置可能な薄型モデル（高さ24.3mm）と、コラージュ機能対応で4面大画面に出力可能なインターフェース拡張モデルをラインナップ

広い動作温度

0°Cから50°Cまで対応し、高温環境でも利用可能です。

高信頼設計

無人運用^{※1}やお客様装置への組み込みなど、24時間連続稼働にも対応可能な高信頼設計です。ファンレス設計により、IoT用途やデジタルサイネージなどほこりの多い環境でも安心してご利用いただけます。

長期供給

組み込み向けプロセッサや長期供給可能な部品を採用することで、製品の販売開始より5年間、同一モデルで製品の長期供給を行います。^{※2}

※1. 電源復旧時に自動的にシステムが起動する仕様となります。無人運用や24時間連続稼働を行う場合、データ破損や故障を防止のためUPS(無停電電源装置)をご利用ください。
 ※2. 市場動向により、メモリやSSDなどのレビジョン変更などを実施させていただく場合がございます。

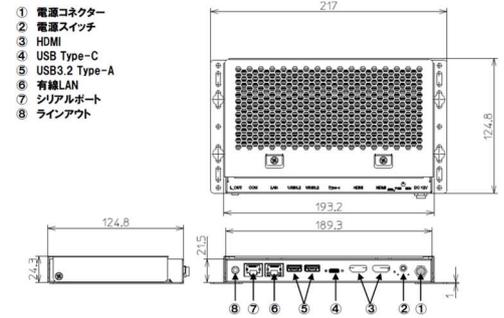
仕様一覧

項目		仕様	
販売形式		BP3L-SC88NM0ELN	BP3E-SC88NM0ELN
OS ^{※1}		Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit	Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit
CPU	名称	Intel N97	AMD Ryzen Embedded R2314
	周波数	2.0GHz Boost 3.6GHz	2.1GHz Boost 2.5GHz
グラフィック	コントローラ名	Intel® HD Graphics 530	AMD Radeon Vega 6 Next-Gen AMD Radeon HD GPU
	最大解像度	4096 x 2160	
メモリ ^{※2}		8GB	
ストレージ ^{※3}	容量	SSD 128GB	
インターフェース ^{※4}	USB	USB3.2 Gen2 Type A x2 USB3.2 Gen2 Type C (DisplayPort Alternate Mode対応)x1	USB2.0 x1、USB 3.2 Gen 1 x2
	シリアル	RS-232C x1 ^{※5}	RS-232C x1 ^{※5}
	有線LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x1	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x2
	外部ディスプレイ	HDMI x2	HDMI x4
ボタン類		電源スイッチ	
	LED	電源LED/ストレージLED	
外形寸法(W x D x H)		約217.0 x 124.8 x 24.3mm	約244.0 x 165.0 x 49.9mm
質量		約1.0kg	約1.75kg
冷却機構		ファンレス	
環境条件	動作時	温度 0~50°C、湿度 20~80% (結露なきこと)	
	保管時	温度 -20~60°C、湿度 20~80% (結露なきこと)	
電源	ACアダプタ	AC100V±10V 50/60±3Hz	
消費電力	最大	約42W	約53W
	OS待機時	約13W	
同梱品 ^{※6}		ACアダプタ、ACコード、取り扱いはの手引き	ACアダプタ、ACコード、HDMI抜け防止金具、取り扱いはの手引き

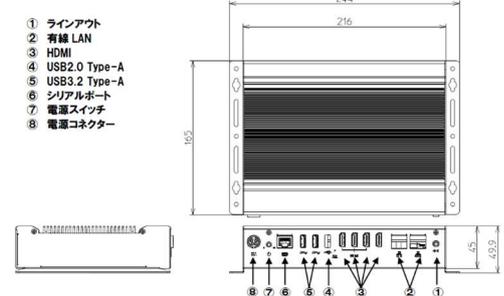
- ※1 Windows®には「マイクロソフトプロダクトアクティベーション」というライセンス認証技術が使われています。ご購入後、お客様にライセンス認証の手続きをしていただく必要があります。
- ※2 Windows® IoT Enterprise モデルには、SSDの書き込み保護機能が搭載されています。SSD保護のため、SSDへの書き込みは不可の状態での使用を推奨しています。
- ※3 メモリ・メモリの一部をビデオRAMとして使用するため、実際に使用可能なメモリは記載の数値より少なくなります。
- ※4 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。
リカバリ領域として15GB使用しているため、ユーザー領域は記載のSSD容量より15GB少なくなります。
- ※5 各インターフェースは、それらのインターフェースに対応するすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
また、USBポートの電源供給能力は、USB2.0は1ポートあたり500mA、USB3.2は1ポートあたり900mAです。
- ※6 シリアルポートを使用する際はオプションの専用ケーブル (RJ45、RS232C変換) をご購入頂く必要があります。
- ※7 出荷時状態のリカバリメディアは同梱されておりません。お客様にてバックアップソフト等を利用し、事前にバックアップを取られることを推奨いたします。
また、ご要望に応じて、別途有償にてご提供させていただきます。
- ※8 その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標・サービス名称です。

寸法・インターフェース

■BP3-L モデル



■BP3-E モデル



安全に関するご注意

ご使用前に、必ず製品付属のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

【このようなときは】 「煙が出たり、異常な音においがする」「内部に水が入った」「製品を落としたり、キャビネットを破損した」このようなときは操作を中止して、電源を切り、電源プラグや接続ケーブルを抜いてください。その後、ご購入先ご相談ください。

*掲載されている製品の内容・仕様は2026年3月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。*本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。*ハードウェアの無償保証は、弊社工場出荷日より1年間です。*本製品には有寿命部品（マザーボード、ACアダプター、SSD、RTCバッテリー等）が使用されています。長時間連続使用など、ご使用状況によっては早期に部品交換（有償）が必要となる場合があります。*Intel、インテル、Intel Atom はアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。*Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。*AMD Ryzenは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。*その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。*本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。

株式会社 日立ケーイーシステムズ

本社
275-0001 千葉県習志野市
東習志野7-1-1
ウェブサイト: <https://www.hke.jp>
E-mail: webmaster@hke.jp

東京オフィス 営業統括本部
136-0071 東京都江東区亀戸
2-22-17 日本生命亀戸ビル
TEL 03-5627-7191(ダイヤルイン)
FAX 03-3683-9565



JQA-EM7340 JQA-QM5747 JQA-IM1046

©Hitachi KE Systems, Ltd. 2026 All Rights Reserved

<お問い合わせ、ご用命は>

KEC250004A 2026.03